

歷史、發展及公司架構

概覽

本公司歷史可追溯至1998年，由袁富根先生及其他六名人士始創於蘇州，是一家提供金屬結構件精密組件服務的公司。2010年4月，本公司A股於深圳證券交易所主板上市，股票代碼是002384.SZ。

歷經多年發展，本集團已成長為全球智能製造的領導者，專注於智能製造領域，致力於為智能連接領域的頂尖科技公司提供先進產品與解決方案。

里程碑

下表載列了本公司主要業務發展里程碑概要：

年份	里程碑
1998年	本公司創立並將總部設於蘇州。
2007年	本公司更名為「蘇州東山精密製造股份有限公司」。
2010年	本公司A股於深圳證券交易所主板上市(股票代碼：002384.SZ)。
2014年	本公司進軍液晶顯示模組業務，並完成對牧東光電的收購，由此進入觸控面板市場。
2016年	本公司完成對位於美國的全球軟板領域領導者MFLEX的併購。
2017年	本公司建立鹽城產業基地，作為本公司的生產中心。
2018年	通過收購領先PCB製造商Multek，完善了本公司PCB市場佈局，具備了高端PCB的製造能力，強化了在互聯解決方案行業的地位。
2019年	本公司於新加坡設立了海外總部。
2022年	本公司於墨西哥建立了我們的首個海外製造工廠。
2023年	本公司開始了泰國工廠的建設以及成功收購了蘇州晶端，擴大了在東南亞的產業佈局。
2025年	本公司通過收購索爾思光電開始了光模塊業務，以及成功完成了對GMD的收購，進一步擴大了我們在歐洲的業務佈局。

歷史、發展及公司架構

主要附屬公司

截至最後實際可行日期，我們通過125家附屬公司開展業務運營。下文載列於往績記錄期間對本集團經營業績作出重大貢獻的附屬公司的主要業務活動、成立地點及成立日期。

附屬公司名稱	成立地點	成立日期	歸屬於 本公司的 權益	主要業務活動
德麗科技	中國	1995年7月19日	100%	生產PCB
蘇州晶端	中國	1996年2月17日	100%	生產液晶顯示器
蘇州維信電子	中國	2002年6月20日	100%	生產軟板
MFLEX Singapore	新加坡	2007年9月3日	100%	海外營銷及銷售
牧東光電	中國	2008年6月6日	100%	研發觸控面板技術及 生產相關組件
鹽城維信電子	中國	2017年6月19日	100%	生產軟板
鹽城東山	中國	2017年6月19日	100%	生產LED封裝及測試
Multek Group	香港	2018年4月25日	100%	投資控股
DSBJ Singapore	新加坡	2019年3月8日	100%	海外運營
鹽城東創	中國	2020年11月2日	100%	生產汽車精密組件
蘇州東越	中國	2022年9月6日	100%	研發及生產汽車精密 組件
MFLEX Thailand	泰國	2023年6月30日	100%	海外生產PCB

公司重大股權變動

早期發展及股份制改造

1998年10月28日，本公司依據中國法律註冊成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣50萬元，股權結構為：袁富根先生持股60%、包文杰先生持股7%、謝雋先生持股7%、呂英女士持股7%、張秀英女士持股7%、陳憶平先生持股7%、周健先生持股5%。1998年至2007年間，本公司歷經多輪增資及股權轉讓，完成後註冊資本增至人民幣33,060,000元。

歷史、發展及公司架構

2007年12月24日，本公司改制為股份有限公司。改制完成後，總股本為人民幣120,000,000元，劃分為120,000,000股股份，具體持股情況為：袁永剛先生持股36.31%、袁永峰先生持股36.31%、袁富根先生持股12.71%、蘇州國發創新資本投資有限公司持股6.75%、本公司當時的其他13名自然人股東合計持股5.42%及上海恒銳創業投資有限公司持股2.50%。

於深圳證券交易所主板上市

2010年4月，本公司A股於深圳證券交易所主板上市(股票代碼：002384.SZ) (「A股上市」)。在本次A股上市中，本公司共計公開發行40,000,000股A股，相當於緊隨A股上市完成後本公司擴大後股本的25%。本次A股上市完成後，本公司股本增至人民幣160,000,000元。

2015年A股非公開配售

2015年4月，本公司進行A股非公開配售(「2015年A股配售」)，募集資金用於LED器件生產項目、液晶顯示模組生產項目及精密金屬結構件生產項目。根據2015年A股配售，合共79,390,270股A股已按每股人民幣14.80元的發行價向六名獨立第三方投資者發行，發行價乃根據多項因素釐定，包括定價日前20個交易日A股的平均交易價格及潛在投資者的指示性投資意向。2015年A股配售募集所得款項淨額約人民幣1,153.8百萬元，截至最後實際可行日期已悉數動用。於2015年A股配售完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣847,390,270元。

2017年A股非公開配售

2017年5月，本公司進行A股非公開配售(「2017年A股配售」)，募集資金用於收購Multi-Fineline Electronix, Inc.100%股權及補充本公司營運資金。根據2017年A股配售，合共223,658,048股A股已按每股人民幣20.12元的發行價向七名獨立第三方機構投資者發行，發行價乃根據多項因素釐定，包括定價日前20個交易日A股的平均交易價格及潛在投資者的指示性投資意向。2017年A股配售募集所得款項淨額約人民幣4,439.3百萬元，截至最後實際可行日期已悉數動用。於2017年A股配售完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣1,071,048,318元。

2020年A股非公開配售

2020年8月，本公司進行A股非公開配售(「2020年A股配售」)以籌集資金，主要用於精細線路PCB擴建項目及Multek PCB生產技術改造項目。根據2020年A股配售，合共103,294,850股A股已按每股人民幣28.00元的發行價向二十名獨立第三方投資者發行，發行價乃根據多項因素釐定，包括定價日前20個交易日A股的平均交易價格及潛在投資者的指示性投資意向。2020年A股配售募集所得款項淨額約人民幣2,864.0百萬元，截至最後實際可行日期已悉數動用。於2020年A股配售完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣1,709,867,327元。

歷史、發展及公司架構

2024年A股註銷

2024年8月，於回購及註銷與僱員激勵計劃項下未授出股份有關的3,953,617股A股後，我們的註冊資本由人民幣1,709,867,327元減少至人民幣1,705,913,710元。

2025年A股非公開配售

於2025年6月，本公司進行A股非公開配售（「**2025年A股配售**」）以補充本公司營運資金，從而促進業務發展，並鞏固最大股東集團對本公司的控制權。根據2025年A股配售，合共125,693,822股新A股已按每股人民幣11.17元的發行價向最大股東集團成員袁永剛先生及袁永峰先生發行，發行價乃根據多項因素釐定，包括定價日前20個交易日A股的平均交易價格及潛在投資者的指示性投資意向。2025年A股配售募集所得款項淨額約人民幣1,391.5百萬元，截至最後實際可行日期已悉數動用。於2025年A股配售完成後，本公司已發行股本總額增至人民幣1,831,607,532元。

收購事項

蘇州晶端

於2022年10月28日，本公司與株式會社日本顯示器（「**JDI**」）簽訂股份購買協議，據此，本公司同意收購JDI持有的蘇州晶端100%的股權，代價為人民幣1,383百萬元（「**蘇州晶端收購事項**」）。蘇州晶端從事開發、設計及生產LCD以及其他電子應用機械類產品及相關零部件。蘇州晶端收購事項預期將加強本公司新能源及智能顯示業務，拓寬本公司產業佈局，提升整體效率及競爭力。蘇州晶端收購事項的代價乃經本公司、JDI及蘇州晶端經公平磋商後釐定，並經考慮蘇州晶端的最新經審核財務業績及參考其他可資比較公司的估值。對蘇州晶端的收購已於2023年1月完成。JDI及蘇州晶端均為獨立第三方。

GMD

於2025年5月12日，DSBJ Singapore與GMD及其所有現有股東訂立股份購買協議，據此，DSBJ Singapore同意以購買價3歐元購買GMD 100%股權並對GMD進行金融債務重組，總結算金額為100百萬歐元（「**GMD收購事項**」）。GMD從事乘用車及商用車零部件的生產。GMD收購事項預計將擴大本公司在汽車零部件領域的影響力，增強我們全球佈局，並提高整體效率及競爭力。GMD股權的購買價及就GMD收購事項與債權人的結算金額乃經公平磋商後釐定，並經考慮GMD的最新經審核財務業績及參考其他可資比較公司的估值。GMD收購事項於2025年10月完成。據董事所深知，GMD、其當時現有股東及彼等各自的實益擁有人均為獨立第三方。

歷史、發展及公司架構

索爾思光電

於2025年6月，本公司連同本公司全資附屬公司Multek Hong Kong Limited與索爾思光電及其現有股東（連同索爾思光電統稱「索爾思光電訂約方」）訂立一系列最終協議，據此，本公司同意(i)向其現有股東收購索爾思光電的97.48%的股權，代價金額不超過約629百萬美元，其中截至最後實際可行日期已支付約371百萬美元；(ii)根據索爾思光電的僱員購股權計劃收購無投票權股份的購股權，代價金額不超過58百萬美元；及(iii)認購索爾思光電發行的可換股債券，金額不超過人民幣1,000百萬元，上述交易須遵守慣例成交條件。本公司擬向獨立第三方一村國際控股有限公司收購索爾思光電剩餘的2.52%的股權。

索爾思光電為於2010年11月17日在開曼群島註冊成立的有限公司，主要從事光模塊的設計、研發、生產及銷售。隨著5G通信、數據中心等行業的快速發展，光模塊需求持續增長。索爾思光電在光模塊領域擁有深厚的技術經驗、先進的研發能力及完整的產業鏈佈局。通過收購索爾思光電，董事相信我們可以借助索爾思光電的技術及市場優勢，快速拓展至光模塊市場。結合索爾思光電在光模塊領域的技術及產品（其應用於數據中心、通信設備等領域），我們認為將形成AI PCB與光模塊相結合的獨特優勢，在客戶資源共享、技術研發協同、製造優化及供應鏈整合等方面有望實現顯著的協同效應。

自2025年10月起，索爾思光電根據國際財務報告準則已於本集團綜合財務報表中合併。就董事所深知，索爾思光電訂約方及其各自的實益擁有人均為獨立第三方。本公司已向主管部門完成申報並將繼續推進相關程序。

在深圳證券交易所主板上市及H股上市的原因

自2010年4月起，本公司A股在深圳證券交易所主板上市。董事確認，自A股上市及直至最後實際可行日期，本公司在任何重大方面未發生任何違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情況。據董事所深知，概無任何有關本公司在深圳證券交易所的合規記錄的重大事項須提請聯交所或[編纂]的潛在投資者注意。中國法律顧問告知我們，自A股上市及直至最後實際可行日期，我們在所有重大方面均已遵守適用於我們的A股上市的相關法律法規。根據聯席保薦人進行的獨立盡職調查及中國法律顧問的上述意見，聯合保薦人未發現任何重大事項使其不同意董事就本公司在深圳證券交易所的合規記錄所作出的確認。

本公司尋求將其H股在聯交所上市，以為擴大產品組合、產能提升、戰略交易、技術研發、智能製造及加強人才梯隊建設籌集額外資金。詳情請參閱「業務 — 我們的增長戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

歷史、發展及公司架構

公眾持股量與自由流通量

根據上市規則第8.08(1)條及19A.13A條，由於本公司除尋求[編纂]的H股外，尚有其他股份，在[編纂]時，公眾人士持有的尋求[編纂]的H股必須(a)佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股)至少10%；或(b)預期市值不少於30億港元。

根據[編纂]將發行的H股總數約佔本公司已發行股本總額的[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。預期[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)，按每股H股[編纂]港元的[編纂](即指示性[編纂]範圍的下限)計算，尋求[編纂]的H股中由公眾人士持有的市值為[編纂]港元，從而符合上市規則第8.08(1)條(經第19A.13A條修訂及取代)的規定。

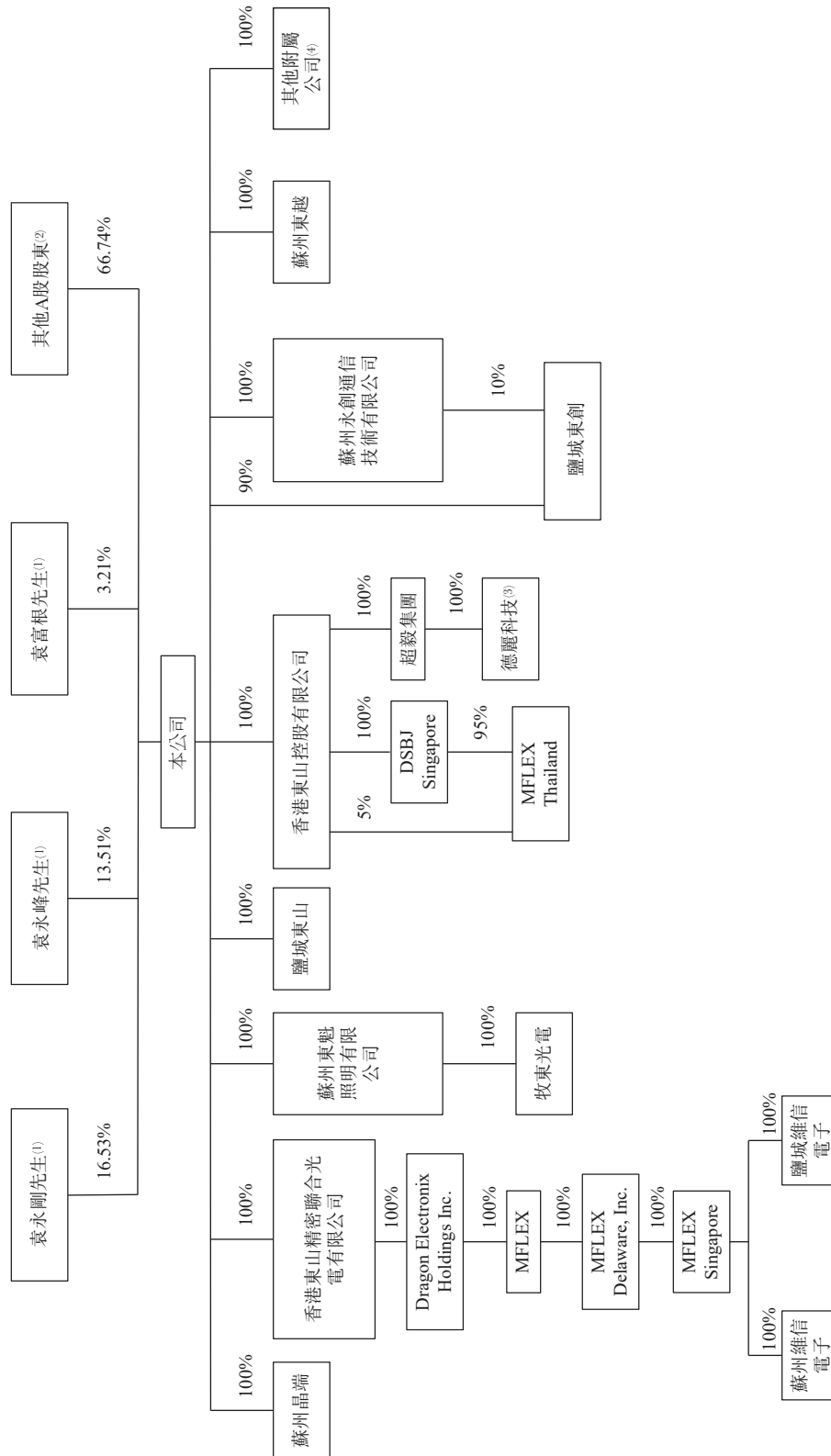
按每股H股[編纂]港元的[編纂](即指示性[編纂]範圍的下限)計算，本公司將滿足上市規則第8.08A條(經第19A.13C條修訂及取代)項下的自由流通量要求。

公司架構

緊接[編纂]前的公司架構

下圖載列緊接[編纂]前本集團的股權及公司架構：

歷史、發展及公司架構



歷史、發展及公司架構

附註：

- (1) 袁富根先生、袁永剛先生及袁永峰先生為最大股東集團。請參閱「與我們最大股東集團的關係」。截至最後實際可行日期，袁永剛先生直接持有302,781,254股A股，其中112,835,143股A股已質押，袁永峰先生直接持有247,526,917股A股，其中62,876,657股A股已質押。
- (2) 截至最後實際可行日期，本公司持有8,839,701股A股作為庫存股，該等股份不附帶任何股東權利，包括但不限於股東會表決權及股息權。
- (3) 德麗科技由超毅集團間接全資擁有。
- (4) 截至最後實際可行日期，其他附屬公司包括(i)於多個司法管轄區成立的101家全資附屬公司；(ii)蘇州捷佈森智能科技有限公司(由本公司及獨立第三方朱文兵先生分別擁有51%及49%的權益)；(iii)蘇州東岱電子科技有限公司(由本公司、獨立第三方錢寶龍先生及獨立第三方陳利民先生分別擁有51%、30.33%及18.67%的權益)；(iv)蘇州艾福電子通訊股份有限公司(由本公司、獨立第三方姜南求先生及獨立第三方蘇州艾伊施德投資管理中心(有限合夥)分別擁有93.51%、6.04%及0.45%的權益)；(v)索爾思光電(由本公司及獨立第三方一村國際控股有限公司分別擁有97.48%及2.52%的權益)。自2025年10月起，索爾思光電已根據國際財務報告準則併入本集團之綜合財務報表。本公司擬收購一村國際控股有限公司於索爾思光電所持有的全部股份及(vi)深圳市勤道東創投資合夥企業(有限合夥)(由本公司、獨立第三方萍鄉市勤道鑫控股權投資基金中心(有限合夥)及獨立第三方深圳市勤道資本管理有限公司分別擁有76.92%、20.77%及2.31%的權益)。有關本公司附屬公司的進一步詳情，請參閱本文件「附錄一A—會計師報告」附註48。
- (5) 上圖所載若干百分比數字已作約整。

緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列緊隨[編纂]完成後本集團的股權及公司架構(假設[編纂]未獲行使)：

